

DIE BONDING

TECHNOLOGIE

TRAÇABILITÉ:

DIMENSION CHIPS: 0.2 - 10mm de côté SUBSTRATS:

WAFER MAPPING

50μm D'ÉPAISSEUR

CÉRAMIQUE COUCHE ÉPAISSE FR4, FR5, G10, G11, ROGERS

FLEX, FLEX RIGIDE, IMS

PYREX

PRÉCISION DE POSE: STANDARD +/- 30µm

SPÉCIFIQUE +/- 15µm

COLLES: CONDUCTRICE

Non-conductrice

SILICONE

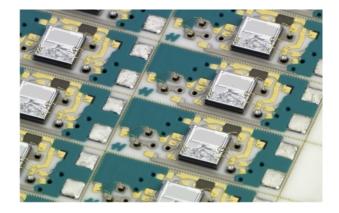
CONDITIONNEMENT: WAFER JUSQU'A 8"

WAFFLE PACK 2 - 4"

GELPACK

Pose de colle: **STAMPING**

> **DISPENSING** SÉRIGRAPHIE



HYBRID SA EST À MÊME DE POSER DES CHIPS DE TAILLE ET D'ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES SUR DIFFÉRENTS TYPES DE SUBSTRATS.

LA PRÉCISION DE POSE ET LES DIVERSES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SE DÉTERMINENT EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT.

